

令和8年10月9日

センシング技術・次世代パッケージングコンソーシアム

半導体製造センシング・実装技術WG

主査 日下 靖之

副査 岩崎 渉、坂田 義太郎、倉島 優一

令和8年度 第1回 半導体製造センシング・実装技術WGのご案内

拝啓

時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は、当コンソーシアムのWG活動に格別のご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。本WGでは、次世代パッケージング技術やその製造・検査等におけるスマートセンシング、インフォマティクス融合など、半導体製造センシング・実装技術に関し、情報共有と議論を通して技術開発要素の課題抽出やプロジェクト提案・実施を目指します。今回は、産業技術総合研究所つくばセンター西事業所において、光電融合研究センターおよび先進パワーエレクトロニクス研究センターの活動紹介ならびに研究施設見学を実施いたします。本WGにおける技術課題や研究開発動向に関する知見を深めるとともに、会員企業間および研究機関との交流を促進する機会として企画しております。ご出席くださいますようお願い申し上げます。11月2日(月)までに参加のご意向をご連絡いただけますと幸いです。

敬具

記

日時：2026年11月19日(木) 13:15～16:30

会場：国立研究開発法人 産業技術総合研究所 つくばセンター 西事業所

13:15 産業技術総合研究所 つくばセンター 西事業所 1 棟本館ロビー集合(受付)

13:30～14:20 光電融合研究センター活動紹介(2 件予定)

光電融合研究センター 担当者

14:20～14:50 研究施設見学

14:50～15:15 移動・休憩

15:15～15:55 先進パワーエレクトロニクス研究センター活動紹介(2 件予定)

先進パワーエレクトロニクス研究センター 担当者

15:55～ 研究施設見学

16:30 解散

※解散後、西 1 棟本館前 16:48 発の産総研連絡バス(つくばセンター行)をご利用いただけます。

お問い合わせ先:半導体製造センシング・実装技術 WG 事務局

(国研)産業技術総合研究所 センシング技術研究部門内

E-mail: M-stri-SenTePack-smapack-ml@aist.go.jp

アクセス・集合場所

集合場所

産業技術総合研究所 つくばセンター

西事業所 西1棟本館ロビー

受付開始: 13:15

当日は受付後、会場にご案内いたします。

TX つくば駅からお越しの方

つくばセンターバスターミナル 4 番のりばから、
関東鉄道バス「学園南循環(左回り)」に
ご乗車ください。

12:55 つくばセンター発

↓

13:06 气象研究所着

降車後、受付・集合場所(西1棟ロビー)まで
徒歩約5分です。

